

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2012 年 1 月 12 日(12.01.2012)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2012/005079 A1

(51) 国際特許分類:

C09J 179/08 (2006.01) H01L 21/60 (2006.01)
C09J 7/00 (2006.01) H01L 25/065 (2006.01)
C09J 11/06 (2006.01) H01L 25/07 (2006.01)
C09J 163/00 (2006.01) H01L 25/18 (2006.01)
H01L 21/301 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2011/063308

(22) 国際出願日: 2011 年 6 月 10 日(10.06.2011)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2010-156503 2010 年 7 月 9 日(09.07.2010) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東レ株式会社 (TORAY INDUSTRIES, INC.) [JP/JP]; 〒1038666 東京都中央区日本橋室町 2 丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 松村和行 (MATSUMURA, Kazuyuki) [JP/JP]; 〒5208558 滋賀県大津市園山 1 丁目 1 番 1 号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 杉本香菜子 (SUGIMOTO, Kanako) [JP/JP]; 〒5208558 滋賀県大津市園山 1 丁目 1 番 1 号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 仁王宏之 (NIWA, Hiroyuki) [JP/JP]; 〒5208558 滋賀県大津市園山 1 丁目 1 番 1 号

東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 稲垣力 (INAGAKI, Chikara) [JP/JP]; 〒2798555 千葉県浦安市美浜 1 丁目 8 番 1 号 東レ株式会社 東京事業場内 Chiba (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: PHOTSENSITIVE ADHESIVE COMPOSITION, PHOTSENSITIVE ADHESIVE FILM, AND SEMICONDUCTOR DEVICE USING EACH

(54) 発明の名称: 感光性接着剤組成物、感光性接着剤フィルムおよびこれらを用いた半導体装置

(57) Abstract: The disclosed photosensitive adhesive composition contains (A) an alkali-soluble polyimide having a particular structural unit and having a particular structure at at least one principal chain terminus, (B) a glycidylamine epoxy composition having a particular structure, (C) a photopolymerizable compound, and (D) a photopolymerization initiator, and the glass transition temperature of the alkali-soluble polyimide (A) is at least 160°C. The photosensitive adhesive composition can form a pattern by means of an alkaline developer, has excellent thermocompression bondability at low temperatures to a substrate having an uneven surface after exposure, and has a high adhesive strength even at high temperatures.

(57) 要約: (A) 特定構造単位を有し、かつ主鎖末端の少なくとも一方に特定構造を有するアルカリ可溶性ポリイミド、(B) 特定構造のグリシジルアミン型エポキシ化合物、(C) 光重合性化合物及び(D) 光重合開始剤を含有し、(A) アルカリ可溶性ポリイミドのガラス転移温度が 160°C 以上である感光性接着剤組成物。本発明の感光性接着剤組成物は、アルカリ現像液によるパターン形成が可能であり、露光後の凹凸付き基板への低温での熱圧着性に優れ、高温時にも高い接着強度を有する。



WO 2012/005079 A1